EQUATE | LLDPE FILM EKSTRÜZYON REÇİNESİ

EFDC-7050

İnce filmlerde maksimum tokluk ve yüksek hızlı işlenebilirlik.

YÜKSEK ÇEKİLME (DRAW DOWN)

GIDA TEMASINA UYGUN

MÜKEMMEL MÜHÜRLEME



Performans Gösterge Paneli

**Değerler 25 mikron film kalınlığında ve 2:1 şişirme (blow-up) oranında test edilmiştir.*

ERİME İNDEKSİ (MFI)

2.0 g/10 dk *(ASTM D 1238)*

YOĞUNLUK

0.918 g/cm³ *(ASTM D 1505)*

ISI KARAKTERİSTİĞİ

Erime: 124 °C | Yığın Yoğunluğu: 530 Kg/m³

FİZİKSEL DİRENÇ

Delinme Enerjisi: 60 J/mm |
Dart Impact: 85 g

OPTİK NETLİK

Pusluluk (Haze): %14 |
Parlaklık (Gloss): 50

ÇEKME MUKAVEMETİ (MD/TD)

31 MPa / 23 MPa

NotebookLM

Hedef Uygulama Alanları

Tokluk ve delinme direnci gerektiren ambalaj çözümleri için ideal reçine.



İnce Astar Filmler

Thin Gauge Liner üretimi. Endüstriyel seviyede yüksek mukavemet ve inceltme imkanı.



Elbise Torbaları

Şeffaflık, optik kalite ve fiziksel dayanıklılığın bir arada gerektiği tekstil ambalajları.



Gıda Ambalajları

Pişirme sırasında gıdayı muhafaza edebilen, yüksek güvenlikli (US FDA ve EC onaylı) paketleme.



Genel Amaçlı Filmler

Yırtılma direncinin (Elmendorf Tear) kritik olduğu çok yönlü endüstriyel ambalaj çözümleri.

NotebookLM

Neden EFDC-7050 Seçilmeli?



Daha İnce Film Hedeflendiğinde

Mükemmel draw down (çekilme) kabiliyeti sayesinde, ürünün mekanik mukavemetinden ödün vermeden çok daha ince (thin gauge) filmler üretebilirsiniz.

Yüksek Hızlı Operasyon Planlandığında

Formülünde bulunan yüksek seviyeli kaydırıcı (slip) ve bloklaşma önleyici (antibbking) ajanlar, yüksek hızlı paketleme ve mühürleme makinelerinde sorunsuz akış sağlar.

Maksimum Tokluk Gerektiğinde

Son üründe yüksek çekme mukavemeti ve üstün yırtılma/delinme direnci talep edilen zorlu uygulamalar için formüle edilmiştir.

NotebookLM

Hangi Durumlarda Alternatif Aranmalı?



Şişirme Film Dışı Proseslerde Kullanılacaksa

Bu reçine özel olarak boru tipi şişirme film (tubular blown film) ekstrüzyonu için tasarlanmıştır. Enjeksiyon veya döküm (cast) gibi farklı prosesler için optimize edilmemiştir.

Tamamen Katkısız (Saf) Reçine İsteniyorsa

EFDC-7050, standart olarak kaydırıcı (slip) ve antiblocking ajanları içerir. Eğer prosesiniz hiçbir katkı maddesi içermeyen tamamen çıplak bir polimer gerektiriyorsa uygun değildir.

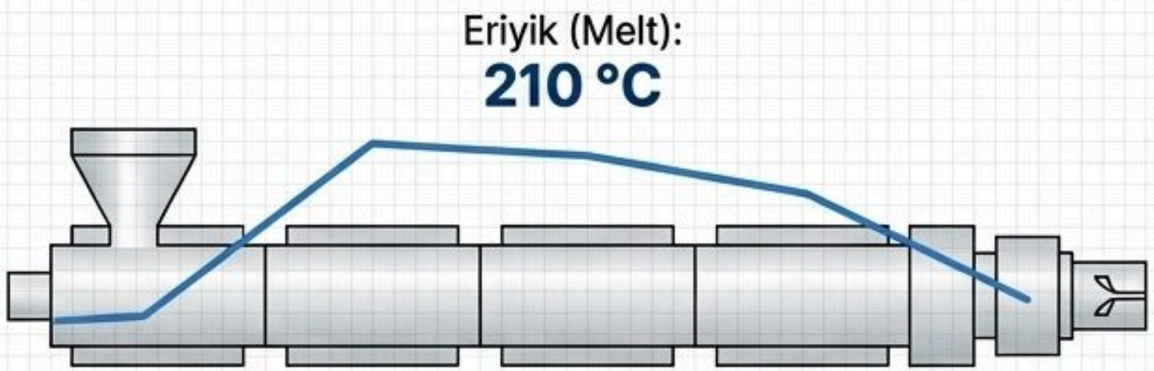
Çok Dar Kalıp Boşluklarıyla Çalışılıyorsa

Ekstrüzyon hattınızdaki kalıp boşluğu (Die gap) 1.8 mm'nin altındaysa kullanılması önerilmez. İdeal çalışma için Die Gap > 1.8 mm olmalıdır.

NotebookLM

Üretim ve Güvenlik Parametreleri

Proses Sıcaklık Profili



Önerilen Ekstrüzyon Sıcaklıkları

Kovan (Barrel): Bölge 1 için 180 °C'den başlayıp Bölge 2'de 210 °C'ye, Bölge 4'te 190 °C'ye inen kademeli profil.

Kritik Depolama & Güvenlik Uyarıları

İklimlendirme:
Toz, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak; serin, kuru ve gölgeli alanlarda depolanmalıdır.

Patlama Riski:
Toz ve ince partikül birikimini önleyecek dökme taşıma sistemleri kurulmalıdır.

Topraklama:
Elektrostatik birikimi önlemek için tüm dökme malzeme taşıma ekipmanları eksiksiz topraklanmalıdır.

NotebookLM

KARAR ÖZETİ VE LOJİSTİK

EQUATE EFDC-7050 LLDPE; yüksek hızda işlenebilirlik sağlayan entegre katkı paketi, olağanüstü delinme direnci ve FDA/EC onaylı gıda uyumluluğu ile ince film ambalaj üretiminde performansı maksimize eder.



25 kg'lık güvenli paletler
(Her palette 55 torba / 1.375 MT net)



15 MT kapasiteye kadar deniz dökme yük (Sea Bulk) konteynerleri

Detaylı Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve Gıda Teması Uygunluk Sertifikaları için EQUATE teknik temsilcinizle iletişime geçin.

EQUATE

NotebookLM